

高流動性

狭ギャップ/ピッチ充填

低ボイド/低ブリード

用途
半導体パッケージ/モバイル
 高密度先端半導体パッケージ (BGA、CSP など)

CV5300 series

キャピラリーアンダーフィル対応
 半導体封止材

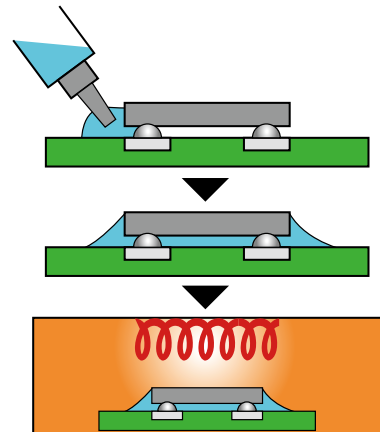
高流動性で狭ギャップ / 狭ピッチの実装に対応する、低ボイドキャピラリーアンダーフィル材料

ラインアップ

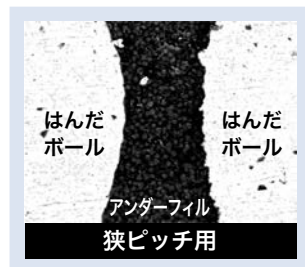
特長

- 1 狭ギャップ対応
- 2 均一浸透性
- 3 高速充填性
- 4 Low-k膜対応
- 5 高耐湿リフロー性

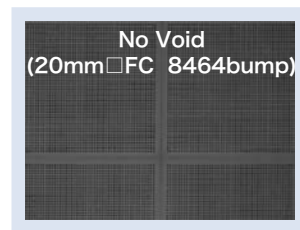
品番	特長
CV5300 series	高流動性、短時間硬化



狭ギャップ/ピッチ充填



低ボイド/低ブリード



一般特性

項目	単位	CV5300 series
フィラーサイズ最大	μm	1
線膨張係数	ppm/°C	33
ガラス転移温度 Tg (TMA)	°C	110
曲げ弾性率 (25°C)	GPa	7

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。

industrial.panasonic.com/jp/electronic-materials

パナソニック インダストリー株式会社 電子材料事業部

Panasonic Industry CV5300

© Panasonic Industry Co., Ltd. 202307